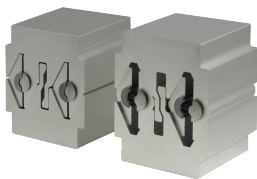


Interscale Flexible Heat Conductor (FHC), 70 mm

Power Utilities



Conductor block expands/contracts vertically to compensate for tolerance stack up and optimizes surface contact and pressure along the thermal path; eliminates the need for a thermal gap pad.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Designed for ATX/ITX/Mini ITX & COM using Intel core-ipcprocessors and AMD processors with the following sockets: Intel: LGA775, LGA1150, LGA1155, LGA1156, LGA1366,LGA2011 ; AMD: AM2, AM2(+), AM3, AM3(+), FM1, FM2, FM2(+)

Compatible with Interscale C enclosures

Provides industry leading conduction cooling performance, 70% improvement over current conduction cooling methods

Conductor block expands/contracts vertically to compensate fortolerance stack up and optimizes surface contact and pressurealong the thermal path; eliminates the need for a thermal gappad

Secured to PCB with mounting brackets, sold separately

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/1

Katalognummer	Typ	Passt zu	Anzahl Verpackungen	Tiefe	Breite
---------------	-----	----------	---------------------	-------	--------

24830-001	Wärmeleiter	Gehäuse	1	50 mm	50 mm
-----------	-------------	---------	---	-------	-------

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Please order the mounting bracket (Intel or AMD, listed under accessories) to assemble the FHC to the board.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE